

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-15

投资者关系 活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 现场参观 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 其他（_____）
活动参与人员（排名不分先后）	中泰证券、大成基金、景顺长城基金、永赢基金、盘京投资、宏利基金、汇添富基金、新华资产、宏利基金、中欧基金、德邦基金、中银基金、华安基金
上市公司接待人员	投资者关系经理：邹云合
时间	2026 年 7 月 14 日
地点	电话及网络会议
形式	电话及网络会议
投资者关系 活动主要内容介绍	交流主要内容： Q1、请介绍 2026 年上半年公司经营业绩预告情况。 2026 年上半年，公司把握存储市场及算力升级带来的发展机遇，叠加广州工厂稳步爬坡产能释放，并通过持续强化工艺技术能力、推进产能建设、优化产品结构、提升运营效率，实现营收与利润同比增长。 2026 年上半年，公司预计实现归母净利润 21.0 亿元~23.0 亿元，预计同比增长 54.4%~69.1%；预计实现扣非净利润 20.8 亿元~22.8 亿元，预计同比增长 64.4%~80.2%。 （2026 年半年度业绩预告数据仅为公司财务部初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露。） Q2、请介绍 2026 年一季度 PCB 业务各下游领域经营拓展情况。 2026 年一季度，受益于算力基础设施建设增加，PCB 通信、数据中心占 PCB 收入占比环比提升；受消费周期阶段性影响，汽车电子收入占比有所下降，其余占比维持稳定。

Q3、请介绍 2026 年一季度封装基板业务经营拓展情况。

2026 年一季度，受益于算力升级及存储市场需求，公司封装基板业务收入占比环比提升，其中应用处理器芯片封装基板占封装基板收入占比提升、存储类封装基板收入环比增加。

Q4、请介绍公司对电子装联业务的定位及布局策略。

公司电子装联业务属于 PCB 制造业务的下游环节，按照产品形态可分为 PCBA 板级、功能性模块、整机产品/系统总装等，业务主要聚焦通信、数据中心、医疗、汽车电子等领域。公司发展电子装联业务旨在以互联为核心，协同 PCB 业务，发挥公司电子互联产品技术平台优势，通过一站式解决方案平台，为客户提供持续增值服务，增强客户粘性。

Q5、请介绍公司南通四期及泰国项目爬坡进展。

泰国工厂与南通四期项目于 2025 年下半年顺利连线投产，目前产能正稳步爬坡。因为该项目仍处于爬坡早期阶段，在产能爬坡过程中，前期投入形成的资产或费用已开始折旧、摊销，但因产量有限，单位产品分摊的固定成本较高，会对公司利润产生一定影响。公司将持续加强内部能力建设，提前做好潜在难点识别，加快重点客户项目引入进程，尽可能缩短爬坡周期，为业务的进一步拓展提供支持。

Q6、请介绍公司广州封装基板项目爬坡进展。

2025 年以来，公司广州封装基板项目产品线能力持续提升，BT 类封装基板产能爬坡稳步推进；FC-BGA 类封装基板方面，22 层及以下产品实现量产，24 层及以上产品技术研发及打样工作按期推进。

Q7、请介绍原材料价格变化情况及对公司的影响。

公司主要原物料包括覆铜板、半固化片、铜箔、金盐、油墨等，涉及品类较多。2026 年继续受到大宗商品价格变化的影响，覆铜板、铜箔、金盐等关键原材料价格同步上行，对公司盈利水平构成一定影响。公司将持续关注国际市场大宗商品价格变化以及上游原材料价格传导情况，并与供应商及客户保持积极沟通。

	Q8、请介绍公司 2026 年资本开支的方向。 2026 年公司资本开支主要聚焦 PCB 与封装基板业务，重点投向无锡深南电路 AI 算力电子电路产品项目、广州封装基板工厂建设，以及南通四期、泰国工厂项目后续款项支付；同时适时开展技术改造，打开瓶颈、释放产能。 Q9、请介绍公司无锡深南电路 AI 算力电子电路产品募投项目情况。 公司无锡深南电路 AI 算力电子电路产品项目总投资 45.36 亿元，其中拟使用募集资金投入 36 亿元，主要生产公司现有高速高密高多层 PCB 产品，用于 AI 服务器、交换机等领域。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单	无